

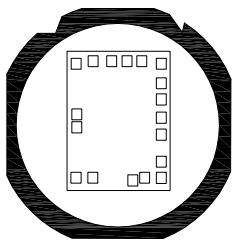
江苏芯丰集成电路封装压焊图

图号: 314BD004

版本

A.1

贴片方向 (芯片与片环方向示意图)



框架传输进料方向

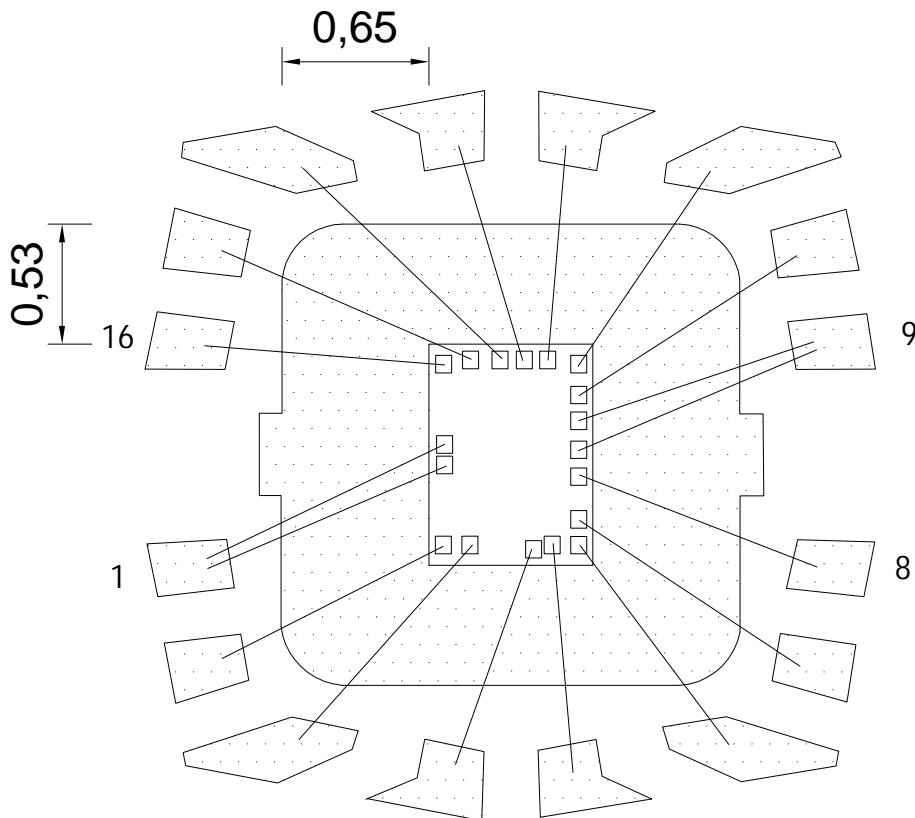
第一个孔为椭圆孔



修改晶圆尺寸

2022.7.28

备注及特殊要求 (Remark&Special Instruction)



顶针		点胶方式	
单顶针	多顶针	点胶	画胶
	/		/
产品型号 (Product Type):		HS8112	
芯片名称 (Die Name):		HS5035	
芯片尺寸: (Die Size):		0.974×0.72mm	
封装形式 (Package Type):		SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)	
引线框 (Lead Frame):		SOP16L(12R)(80×80)	
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):		雾锡	
晶圆尺寸 (Wafer Size):		6寸	
吸嘴 (suction nozzle)		RR20×20	
拟制 (Prepared by)		钱培丽 2022.7.19	
线材直径 (Wire Diameter):		银合金线0.8mil	
压焊点尺寸 (Pad Opening):		60×60um	
最小压焊间距 (Min Pitch):		90um	
先焊线 (Wire Bond Start):		/	
焊线总数 (Quantity of Wire):		18	
最长线长 (Length of longest Wire):		1.21mm	
顶层铝厚 (Top Al Thickness):		1.2um(2层)	
切割道 (Cutting Way)		80um	
芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)		220±10um	
装片胶 (Epoxy)		9246LB5(导电胶)	
塑封料 (Molding Compound)		GR710GN	
RF 芯片		/	
LOW-K芯片		/	
CUP/BOAC		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
RF 芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
LOW-K芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
批准 (Approved by)			